



Fiji G2 F200 PEALD

远程等离子体增强原子层沉积系统

功能特点:

※ 采用热法和等离子法制备原子层纳米级薄膜沉积:

- 可以沉积有机物材料, 做表面亲疏水性处理
- 可实现低饱和蒸气压材料沉积

※ 涡轮分子泵抽气系统

※ 先进的等离子体设计

※ 人性化的操作界面

※ 可增加在线椭偏仪和 QCM 检测

※ 可扩展臭氧发生器

※ 可集成手套箱设备

※ 可增加 Load Lock

应用领域:

※ 芯片封装、半导体 High-k 介电层、纳米涂层、3D 涂层、锂电池、催化剂、太阳能电池、
生物学仿生、荧光材料、OLED 显示、有机材料、电子电路、光学膜等。



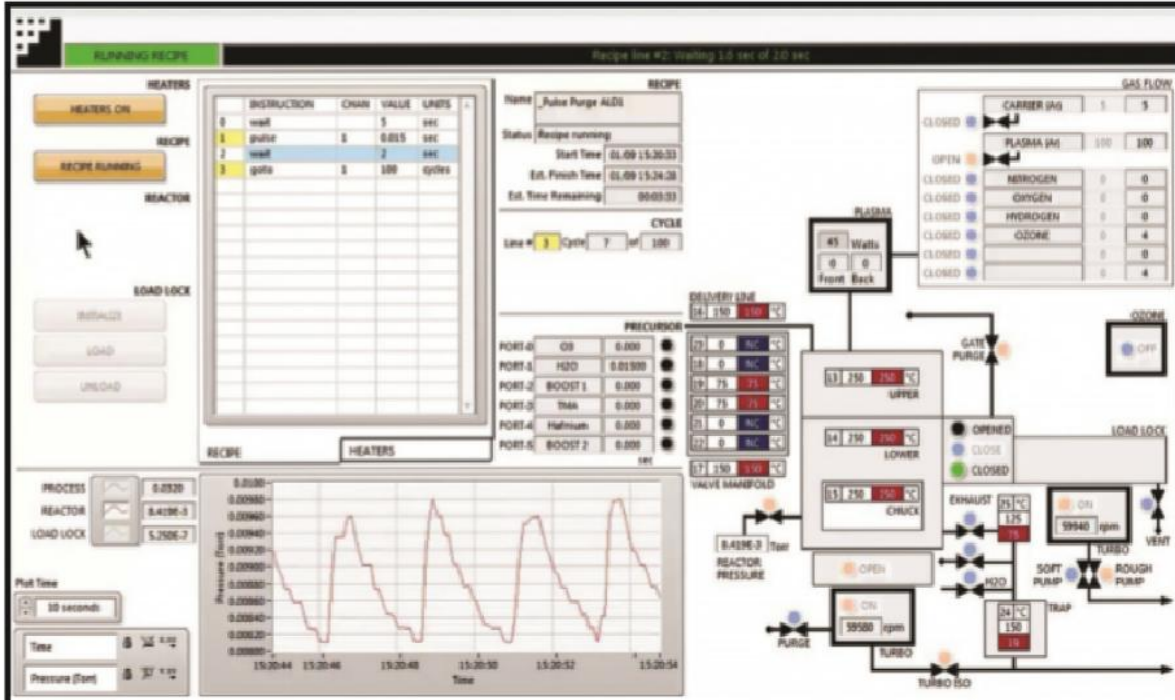
系统参数:	
工作模式	Continuous Mode™ (传统热法 ALD)
	Exposure Mode™ (高深宽比 ALD)
	Plasma Mode™ (PEALD)
基片尺寸	最大 200mm (8")
基片温度	标配 200mm 基片尺寸, 可加热 500℃; 选配 100mm 基片尺寸, 可加热 800℃
沉积均匀性 (Al ₂ O ₃)	<1.5% (1σ) 热法; <1.5% (1σ) 等离子法
前驱通道	标配 4 路, 可扩展至 6 路, 每路均可通固、液、气前驱物, 各路均可独立加热至 200℃
	工业级 ALD 专用快速阀门, 响应时间 10ms
	标配 50ml 不锈钢钢瓶, 可以选配更大容量
运载气体	100sccm Ar 气、200sccm Ar 气等离子体、100sccm N ₂ 气等离子体、100sccm O ₂ 气等离子体或 100sccm H ₂ 气等离子体, 均有 MFC 控制
真空泵	干泵, >50CFM
工作电源	220-240VAC, 4500W (不含泵)
操作系统	Labview™, Windows™7, Lenovo Laptop PC
外观尺寸 (W x D x H)	1600 x 715 x 1920mm, 1845 x 715 x 1920mm (含 load lock)
兼容性	100 级洁净室
质量认证	CE, TUV, FCC
系统选配	椭偏仪接口
	QCM
	RGA 接口
	OES 光电直读光谱仪
	Wafer Plus
	Ozone Generator
	Glove Box Interface
	LVPD
	Load Lock



可沉积膜层:

膜层分类	膜层材料
氧化物	Al ₂ O ₃ , HfO, La ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , ZnO, ZrO ₂ , Ta ₂ O, In ₂ O ₃ , SnO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MnO _x , Nb ₂ O ₅ , MgO, Er ₂ O ₃ , WO _x , MoO ₃ , V ₂ O ₃ , CeO _x
氮化物	WN, Hf ₃ N ₄ , Zr ₃ N ₄ , AlN, TiN, NbN _x , TaN, CoN, SiN, MnN, NbTiN
硫化物	ZnS, MoS ₂ , WS ₂ , VS ₂
金属	Ru, Pt, W, Ni, Fe, Co, Mn, Cu
复合物	AZO, ITO, ATO, ZnOS, HfSiO _n , LiMnO _x
有机物	FOTS, FDTS, Thiols

操控界面: 专业化 开放化 人性化



通过 GUI 操控界面可以实现参数设置、系统动态监控、数据记录、存储与显示，用户可以自编程。